

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-200464
(P2004-200464A)

(43) 公開日 平成16年7月15日(2004.7.15)

(51) Int. Cl.⁷
H05K 3/20

F I
H05K 3/20

テーマコード(参考)
5E343

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号	特願2002-368087 (P2002-368087)	(71) 出願人	390001812 アンデン株式会社 愛知県安城市篠目町井山3番地
(22) 出願日	平成14年12月19日(2002.12.19)	(71) 出願人	000004260 株式会社デンソー 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
		(74) 代理人	100100022 弁理士 伊藤 洋二
		(74) 代理人	100108198 弁理士 三浦 高広
		(74) 代理人	100111578 弁理士 水野 史博
		(72) 発明者	久田 剛巧 愛知県安城市篠目町井山3番地 アンデン株式会社内

最終頁に続く

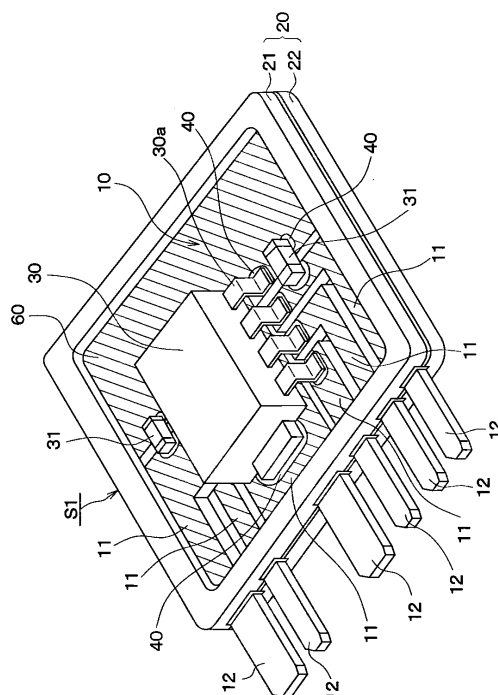
(54) 【発明の名称】 金属配線板

(57) 【要約】

【課題】 金属板を所定の回路パターン形状をなす配線部を有するように加工してなる金属配線板の表面に、狭ピッチのリードを有する電子部品をはんだ付け実装するにあたって、金属配線板のはんだ付け部に適切且つ安価にはんだ付けできるようにする。

【解決手段】 金属板10を所定の回路パターン形状をなす配線部11およびターミナル12を有する形状に加工してなり、表面に電子部品30、31がはんだ付けされるはんだ付け部40を有する金属配線板S1において、当該表面のうちのはんだ付け部40を除く領域にソルダーレジスト60が形成されている。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

金属板(10)を所定の回路パターン形状をなす配線部(11)を有するように加工してなる金属配線板(S1)において、

前記金属配線板の表面には、電子部品(30、31)がはんだ付けされるはんだ付け部(40)を有しており、

前記表面のうち前記はんだ付け部を除く領域には、ソルダーレジスト(60)印刷が施されていることを特徴とする金属配線板。

【請求項 2】

前記金属板(10)を加工することによって、前記配線部(11)と一体であって外部との接続を行うためのターミナル(12)が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の金属配線板。 10

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、金属板を所定の回路パターン形状をなす配線部を有するように加工してなる金属配線板に関し、特に、表面に電子部品をはんだ付け実装するようにした金属配線板に関する。

【0002】**【従来の技術】**

従来より、金属板を所定の回路パターン形状をなす配線部を有するように加工してなる金属配線板としては、車両のリレーボックス等に用いられるバスバー配線板が一般的である(例えば、特許文献1参照)。 20

【0003】

このバスバー配線板は、銅やアルミ等の金属板を打ち抜き加工やエッチング加工等により加工したものである。このバスバー配線板は、通常の印刷配線板に比べて金属板自体が配線部となるため、配線厚さが大きく、大電流を流すことができる。

【0004】**【特許文献1】**

特開平6-55971号公報(第3頁、第1-2図) 30

【0005】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明者らは、バスバー配線板の表面にパワー素子やSMD素子等の電子部品をはんだ付け実装することを検討した。これは、上述したように、バスバー配線板が大電流に対応可能であることや、また、バスバー配線の放熱効果を考慮すると、大電流が流れ発熱も大きいパワー素子等に対してバスバー配線板が好適であると考えたためである。

【0006】

しかしながら、バスバー配線板の表面にはんだ付けにより電子部品を実装するには、配線パターン間の短絡を防止する等の意味から、バスバー配線板表面のはんだ付け部以外の部位には、はんだが付かないように工夫する必要がある。 40

【0007】

そこで、本発明者らは、バスバー配線板を樹脂でインサート成形することによって、バスバー配線板の表面のうちはんだ付け部を除く領域を樹脂で被覆して固めることを検討した。それによれば、樹脂で被覆された部位でははんだが付かないようにできる。

【0008】

しかし、このようなインサート成形を行う方法はコスト的に不利であるとともに、樹脂で被覆した場合、その樹脂自体の厚みにより樹脂部分とバスバー配線板の電子部品搭載面がフラットにならず段差が生じることからはんだ付けしにくくなることや、さらに、樹脂の成形型の強度上の都合から細かい型形状を採用することが困難であった。

【0009】

そのため、例えばSOP（スモールアウトラインパッケージ）やQFP（クワッドフラットパッケージ）等のようなリードが狭ピッチ（例えば0.数mm）である電子部品を実装しようとした場合、狭ピッチであるはんだ付け部に対応して、樹脂を精度良くバスバー配線板上に配置することが困難であった。

【0010】

本発明は上記事情に鑑み、金属板を所定の回路パターン形状をなす配線部を有するように加工してなる金属配線板の表面に、狭ピッチのリードを有する電子部品をはんだ付け実装するにあたって、金属配線板のはんだ付け部に適切且つ安価にはんだ付けすることを目的とする。

【0011】**【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、金属板（10）を所定の回路パターン形状をなす配線部（11）を有するように加工してなる金属配線板（S1）において、金属配線板の表面には、電子部品（30、31）がはんだ付けされるはんだ付け部（40）を有しており、当該表面のうちはんだ付け部を除く領域にはソルダーレジスト（60）印刷が施されていることを特徴とする。

【0012】

ソルダーレジストはマスクを用いた印刷法により形成できるため、上述した樹脂のインサート成形に比べて、精度良く微細な配置形状が可能であり、また、インサート成形される樹脂に比べて安価に形成することができる。

【0013】

さらに、ソルダーレジスト印刷では、金属配線板の表面を樹脂で被覆し絶縁層を形成した場合に比べて薄く形成することができ、電子部品搭載面をフラットとすることができるので、容易に且つ高い信頼性のはんだ付けを行うことができる。

【0014】

よって、本発明の金属配線板によれば、金属配線板の表面に、狭ピッチのリードを有する電子部品をはんだ付け実装するにあたって、金属配線板のはんだ付け部に適切且つ安価にはんだ付けすることができる。

【0015】

また、請求項2に記載の発明では、金属板（10）を加工することによって、配線部（11）と一体であって外部との接続を行うためのターミナル（12）が形成されていることを特徴とする。

【0016】

本発明では、金属板を打ち抜き加工やエッチング加工等によって配線部を形成することができるため、その配線部の端部をそのままターミナルとして構成することができ、このターミナルによって金属配線板と外部との電気的な接続が適切に行われる。

【0017】

ちなみに、従来より、金属ベース上に絶縁層を介して導電性箔を設けた金属ベース基板（図3参照）が知られているが、この金属ベース基板では、ターミナルは別体のものとして形成する必要があり、手間がかかる。

【0018】

それに対して、本発明では、金属板の加工により、加工された金属板の一部そのものをターミナルとして構成することができるため、別途ターミナルを形成することが不要であり、金属ベース基板に比べて安価であるという利点がある。

【0019】

なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。

【0020】**【発明の実施の形態】**

以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。図1は本発明の実施形態に係る金属

10

20

30

40

50

配線板 S 1 に電子部品 3 0、3 1 をはんだ付け実装した実装構造を示す斜視図である。この金属配線板 S 1 は、例えば車両の各種コントローラとしてリレーボックス等に搭載することができる。

【0021】

図 1 に示される金属配線板 S 1 は、銅系金属からなる金属板 1 0 をプレスによる打ち抜き加工を用いて加工したものである。この金属板 1 0 は、プレス加工用として板厚が 5 0 0 μm 以上のものを採用しており、例えば 6 4 0 μm 程度のものとできる。そして、金属板 1 0 は、所定の回路パターン形状をなす配線部 1 1 を有する形状にプレス加工されている。

【0022】

こうして、金属配線板 S 1 は、プレス加工された金属板 1 0 すなわち所定の回路パターン形状をなす配線部 1 1 の集合体として構成されている。また、本実施形態の金属配線板 S 1 においては、各配線部 1 1 の端部が外部との接続を行うためのターミナル 1 2 として形成されている。

【0023】

さらに、本実施形態では、加工された金属板 1 0 の周辺部に設けられているケース 2 0 によって各配線部 1 1 が一体に固定されており、上記集合体としての金属配線板 S 1 が構成されている。

【0024】

本例では、ケース 2 0 は、セラミックや樹脂等の電気絶縁性材料からなるもので、上ケース 2 1 と下ケース 2 2 とからなる。そして、各配線部 1 1 を上下ケース 2 1、2 2 によって挟持し、上下ケース 2 1 と 2 2 とを係合や接着等にて接合することによって、各配線部 1 1 が固定されている。ここで、ターミナル 1 2 はケース 2 0 の外側に突出している。

【0025】

このような金属配線板 S 1 においては、その表面にパワー素子や抵抗、コンデンサ等の表面実装部品 (SMD 素子) として各種の電子部品 3 0、3 1 がはんだ付け実装されている。本発明では、好適には表面実装部品が良く、例として、パワー MOS トランジスタ等を有する SOP としてのパワー素子 3 0 と抵抗素子 3 1 とが図示されている。

【0026】

本例では、パワー素子 3 0 のリード (アウターリード) 3 0 a および抵抗素子 3 1 が、金属配線板 S 1 におけるはんだ付け部 4 0 にはんだ付けされている。パワー素子 3 0 のリード 3 0 a におけるはんだ付け部 4 0 の拡大断面図を図 2 に示す。図 2 に示すように、当該リード 3 0 a と金属配線板 S 1 の配線部 1 1 とがはんだ 5 0 を介して接続されている。

【0027】

そして、図 1 に示すように、本例では、金属配線板 S 1 における隣り合う配線部 1 1 の間をブリッジするように各電子部品 3 0、3 1 がはんだ付けされたものとなっている。

【0028】

ここで、本実施形態では、図 1 に示すように、金属配線板 S 1 において表面のうちはんだ付け部 4 0 およびターミナル 1 2 を除く領域に、ソルダーレジスト 6 0 を形成した独自の構成を採用している。図 1 では、便宜上ソルダーレジスト 6 0 に斜線ハッチングを施してある。

【0029】

このソルダーレジスト 6 0 は、ガラスエポキシ基板や紙フェノール基板等を用いた通常の印刷配線基板に施されるものと同様に、スクリーン印刷法等のマスクを用いた印刷法によって形成されるものである。そして、はんだ 5 0 を配設する際、ソルダーレジスト 6 0 の部分にははんだ 5 0 の付着が防止される。

【0030】

このように、ソルダーレジスト 6 0 はマスクを用いた印刷法により形成できるため、「課題」の欄にて述べたような金属配線板を樹脂でインサート成形する方法に比べて、精度良く微細な配置形状が可能であり、また、インサート成形される樹脂に比べて安価に形成す

10

20

30

40

50

ることができる。

【0031】

さらに、ソルダーレジスト印刷では、金属配線板S1の表面を樹脂で被覆し絶縁層を形成した場合に比べて、ソルダーレジスト60を薄く形成することができ、電子部品搭載面をフラットとすることができるので容易にはんだ付けすることができる。

【0032】

そのため、本実施形態によれば、金属配線板S1の表面に、狭ピッチ（例えば0.数mm）のリード30aを有するパワー素子30をはんだ付け実装するにあたって、金属配線板S1のはんだ付け部40に適切に且つ安価にはんだ50を付けることができる。

【0033】

また、本実施形態の金属配線板S1では、金属板10を加工することによって、配線部11と一体のターミナル12が形成されており、ソルダーレジスト60はターミナル12の表面には形成されていない。

【0034】

そして、このようにターミナル12を形成した金属配線板S1において、そのターミナル12の表面にソルダーレジスト60を形成しないことにより、ターミナル12と外部との電気的な接続が適切に行われる。

【0035】

ちなみに、図3に示すように、従来より、銅やアルミ等からなる金属ベースJ1上にガラスエポキシ樹脂等からなる絶縁層J2を介して、銅等からなる導電性箔J3を設けた金属ベース基板が知られている。しかし、この金属ベース基板では、ターミナルは別体のものとして形成する必要があり、手間がかかる。

【0036】

例えば、導電性箔J3にターミナルを溶接やはんだ付けして設けたり、金属ベースJ1に穴を空け当該穴にターミナルを挿入して設けたりする必要がある。しかも、金属ベースJ1に上記穴を設ける場合には、その穴に絶縁物を充填する等によって絶縁構造を持たせなければならない。

【0037】

それに対して、本実施形態では、加工された金属板10の一部そのものをターミナル12として構成することができる。

【0038】

すなわち、本実施形態では、金属板10をプレスでの打ち抜き加工によって配線部11を形成し、その配線部11の端部をそのままターミナル12として構成することができる。そのため、別途ターミナルを形成することが不要であり、上記金属ベース基板に比べて安価にターミナル形成を行うことができる。

【0039】

次に、上記金属配線板S1の製造方法および図1に示す実装構造の形成方法について、その一例を図4も参照して述べる。図4は金属配線板の製造方法を示す平面図であり、この図4においても、便宜上ソルダーレジスト60に斜線ハッチングを施してある。

【0040】

まず、図4(a)に示すように、金属板10を用意する。この金属板10の表面のうち上記はんだ付け部40およびターミナル12となる部位を除く領域に、ソルダーレジスト60をスクリーン印刷法等のマスクを用いた印刷法にて形成する（レジスト印刷工程）。

【0041】

次に、図4(b)に示すように、金属板10の不要部をプレスによる打ち抜き加工によって除去し、所定の回路パターンに対応した配線部11およびターミナル12を有する形状とする（金属板加工工程）。この打ち抜き後の状態では各配線部11は、フレーム部13によって一体に連結されている。

【0042】

次に、図示しないが、上記ケース20（上ケース21と下ケース22）によって各配線部

10

20

30

40

50

11を支持固定し、続いて、フレーム部13を切断して除去する。これにより本実施形態の金属配線板S1ができあがる。

【0043】

その後、はんだ50を印刷法にてはんだ付け部40に配設し、電子部品30、31を搭載した後、リフローしてはんだ付けを行う。こうして、上記図1に示す実装構造ができあがる。

【0044】

(他の実施形態)

なお、上記例では、金属配線板S1の表面のうち側面にはソルダレジスト60が形成されていないが、この側面においてもはんだ付け部以外の部位にはソルダレジストが形成されていても良い。

10

【0045】

つまり、金属配線板S1の表面とは、金属配線板S1の外面全体であり、上記図1に示されていない外面も含む。例えば、図1中の金属配線板S1において電子部品30、31が実装されている面と反対側に位置する図示されない面(反対面)にも、電子部品をはんだ付け実装して良い。その場合には、当該反対面においても、はんだ付け部以外にソルダレジストを設ければ良い。

【0046】

また、配線部11の集合体としての金属板10は、上記例のようにケース20によって固定されたものでなくてもよく、その固定方法は限定されない。例えば、個々の配線部11をセラミックや樹脂等の絶縁性材料からなる板やケース等に接着固定したものであっても良い。

20

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係る金属配線板に電子部品をはんだ付け実装した実装構造を示す斜視図である。

【図2】はんだ付け部の拡大断面図である。

【図3】金属ベース基板の概略断面図である。

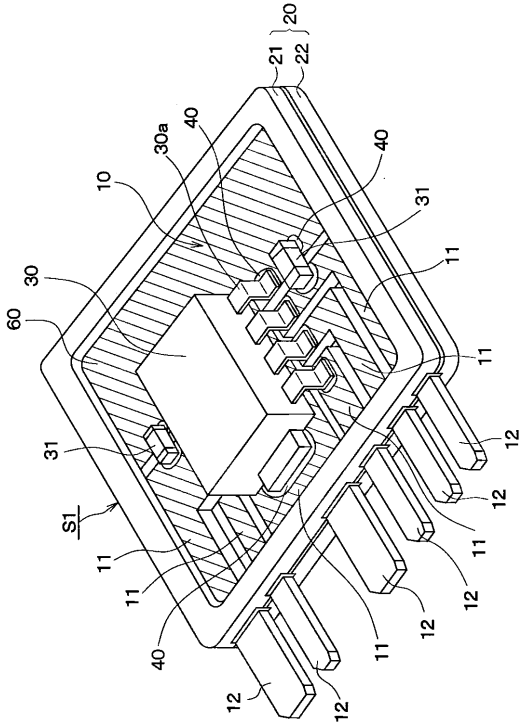
【図4】本発明の実施形態に係る金属配線板の製造方法を示す図である。

【符号の説明】

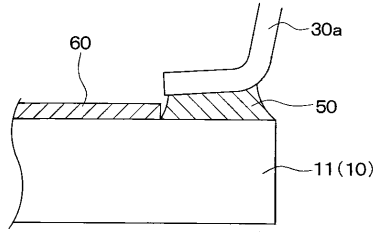
10...金属板、11...配線部、12...ターミナル、30...パワー素子、
31...抵抗素子、40...はんだ付け部、60...ソルダレジスト、
S1...金属配線板。

30

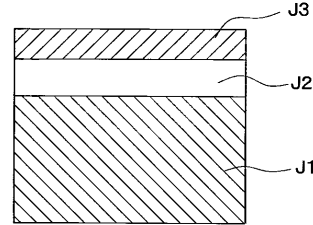
【 図 1 】



【 図 2 】

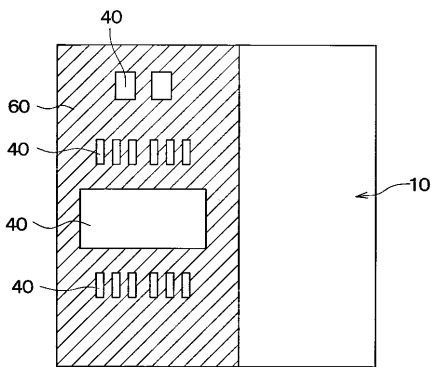


【 図 3 】

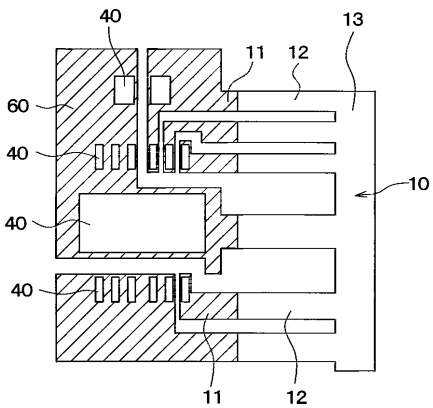


【 図 4 】

(a)



(b)



フロントページの続き

(72)発明者 杵屋 博文

愛知県安城市篠目町井山3番地 アンデン株式会社内

Fターム(参考) 5E343 BB24 BB67 DD56 DD62 EE33 GG11